8410

Product Information

Cinta termoactivable

Descripción del producto

tesa® 8410 HS cinta doble faz café termoactivable basada en una resina fenólica reactiva y caucho de nitrilo.

Características

- Reliable chip module bonding
- Suitable for PVC, ABS, PET, and PC cards
- Good workability on all common implanting lines
- Outstanding ageing resistance
- Lifelong flexibility due to high rubber content

Aplicación

tesa HAF 8410 HS está diseñada para la implementación de chips en tarjetas con altos requerimientos en cuanto a seguridad y durabilidad.

- Adecuada para tarjetas de PVC, ABS, PET y PC.
- Funciona perfectamente en todas las líneas de implementación de chips.
- Resistente al envejecimiento.
- Flexible durante el tiempo de vida útil de la cinta gracias a su componente de caucho.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	ninguno	• Espesor total	60 µm
• Tipo de adhesivo	caucho nitril / resina fenólica	• Color	Ámbar
• Tipo de protector	glassine		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Fuerza de adhesión (esfuerzo dinámico)	12 N/mm^2

Additional Information

Recomendaciones técnicas para aplicación en tarjetas con chip:
Los parámetros óptimos dependen del tipo de máquina, de los materiales de las tarjetas, de los chips y de los requerimientos del cliente.

For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=08410

8410

Product Information

Additional Information

1- Pre-laminado:
Durante el pre-laminado la cinta se lamina sobre la tira que contiene los chips. Este proceso se puede llevar a cabo inline u offline. El pre-laminado no afecta la caducidad de la cinta. Los módulos pre-laminados pueden ser almacenados durante el mismo tiempo de vida útil de la cinta.

Configuración de la máquina:

- Temperatura 120° - 140°C
- Presión 4 - 6 bar
- Tiempo 1.5 - 3 sec.

2.- Implementación de los chips.
Durante la implementación de los chips, estos son cortados de la tira de chips, posicionados en la cavidad de la tarjeta y unidos permanentemente a la tarjeta. En este paso, los parámetros dependen del tipo de equipo usado. Actualmente hay dos formas de hacerlo:

Proceso con un solo paso - Configuración de la máquina (baja temperatura):

- Temperatura[1] 160° – 180 °C
- Presión 65 N/chip
- Tiempo 2.0 – 4.0 s

Un solo paso - Configuración de la máquina (alta temperatura):

- Temperatura[1] 180° – 200 °C
- Presión 65 N/chip
- Tiempo 1.0 – 1.5 s

Proceso con varios pasos (2 o más pistones) - Configuración de la máquina:

- Temperatura[1] 170° – 200 °C
- Presión 65 N/chip
- Tiempo (para cada paso) 0.7 – 1.2 s

[1] Temperatura medida dentro del piston.

Para otras aplicaciones diferentes de las tarjetas chip otros parámetros de configuración deberían ser usados. Ver las condiciones de almacenamiento de las cintas tesa® HAF para la caducidad de las mismas.

Nota: Los valores de adhesión son obtenidos bajo condiciones de laboratorio estándard (valores medios). Condiciones del test: Material aluminio y temperatura 120°C, presión 10 bar y tiempo 8 minutos.

8410

Product Information

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=08410